**3D打印机技术要求**

1. 打印技术：熔融堆积（FDM）；
2. 成型平台材质：磁扣玻璃（玻璃尺寸≥11mm\*13mm磁扣直径≥0.8mm），平台温度：120℃（可在打印过程中适时调整）；
3. 内螺纹式喷嘴直径：0.4mm（0.2-0.5mm任意可选），喷嘴最高温度可达260℃；
4. 全钣金件封闭式机箱，稳定安全可靠；自带储物箱体；
5. 悬挂式喷头数量：1个（可扩展至2个或多进一出）；
6. 4.3寸全彩触摸屏，45度右方倾角显示模式，符合人体工程力学。左右平衡对称式丝杠设计，保持绝对平稳；
7. 支持语言：中/英/俄文。采用四点调平模式，支持手动修改；
8. 机器尺寸：≤530×530×1300mm，打印尺寸≥360×350×560mm；
9. 打印精度：0.05（至0.4可调），XY轴定位：0.01mm，Z轴定位：0.0025mm，并具有抱死功能，保证平台绝对位置；
10. 打印速度：10-150mm/s（可在打印状态下适时调整）；
11. 打印方式：支持USB连接或SD卡脱机打印；
12. 环境要求：5-50℃，湿度5-50%；
13. 耗材类型：PLA、ABS、HIPS、PVA、PE、PP、PETG、木屑、碳纤维、尼龙、渐变色等；
14. 耗材直径：1.75mm；
15. 支持断电续打功能、安全防护功能、低电压开关功能、一键进料/一键退料功能、断料报警和断料检测功能；
16. 提供3D模型Hori数据处理软件（切片软件），功能如下：  
    1）硬件厂家自主研发的专业3D模型数据处理软件，有专利证书；  
    2）软件可以查询观察打印轨迹；  
    3）具备固件升级的功能；  
    4）可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动装配和自动分割模型功能；具备X轴、Y轴、  
     Z轴和自由切割功能；  
    5）具有自定义手动支撑功能；可与软件默认支撑同时进行；  
    6）分配多个作业的打印队列，以及预计打印时间和材料消耗；  
    7）可支持文件格式：STL、OBJ、DAE、AMF、BMP、JPG、JPEG、PNG、G、GCODE；  
    8）软件识别语言：中文；
17. 打印机硬件、打印机主板控制软件、打印机切片软件均具备自主产权证书，专利所有人归属同一家公司，确保产品自主研发, 可提供持续升级和服务；
18. 打印机厂家具备以下资质：  
    1）软件产品具备国家自主知识产权“计算机软件著作权登记证书”；  
    2）产品有通过CE、FCC和ROHS认证；  
    3）企业具有国家工信部颁发的“中国增材制造产业联盟理事单位”证书。

以上所有技术要求签订合同前需提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书或官网资料及资料链接）备查